

性能特点：

- 通带频率：DC~18GHz
- 通带损耗：2.1dB@18GHz
- 阻带抑制：30dB@21GHz
- 回波损耗：15dB
- 芯片尺寸：0.8mm×1mm×0.1mm

产品简介：

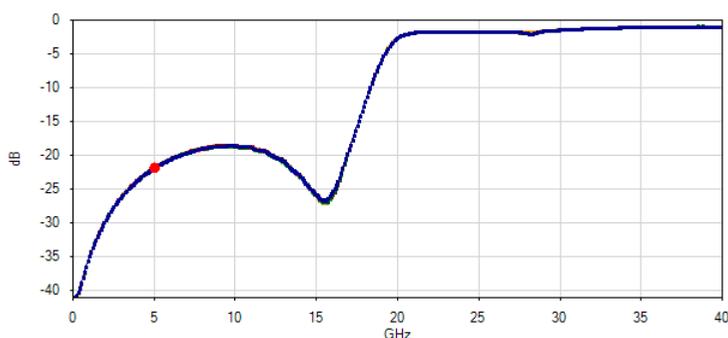
HH-LF0018L 是一款 GaAs MMIC 低通滤波器芯片，该低通滤波器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、易集成等特点。其频率范围覆盖 DC~18GHz。

电参数：(T_A=25℃)

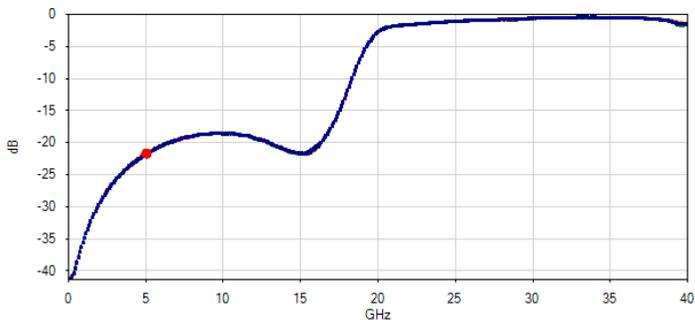
| 指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------|-------|-----|-----|-----|
| 频率范围 | DC~18 | | | GHz |
| 插入损耗 | - | 2.1 | - | dB |
| 阻带抑制 | - | 30 | - | dB |
| 回波损耗 | - | 15 | - | dB |
| 输入功率 1dB 压缩点 | - | 26 | - | dBm |

使用限制参数：

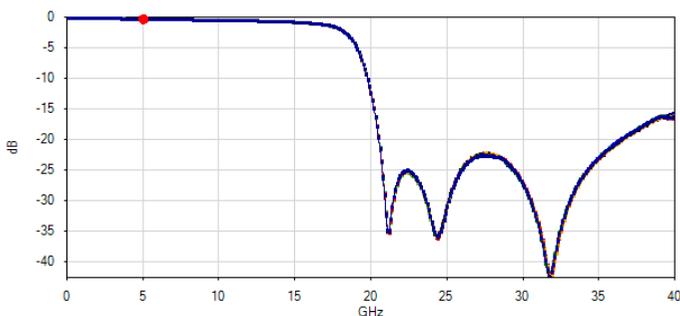
| | |
|------|-----------|
| 输入功率 | +30dBm |
| 存储温度 | -65℃~175℃ |
| 使用温度 | -55℃~85℃ |

典型曲线：


输入回波损耗

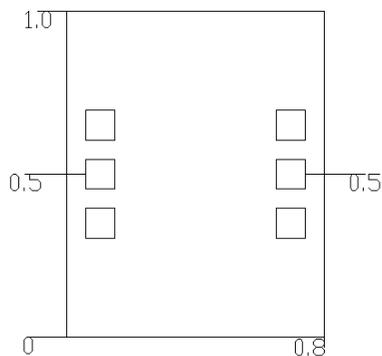


输出回波损耗

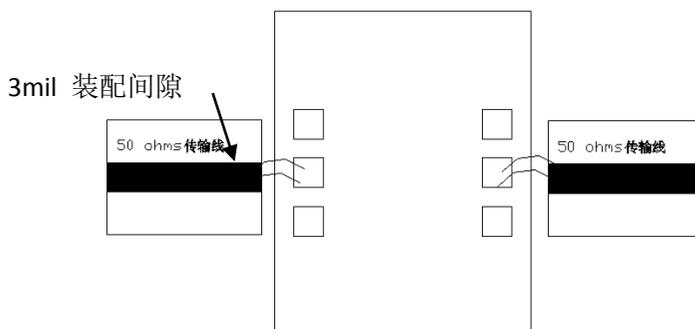


插入损耗

尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）